

先進記憶體的領航者

DuraMemory™ / DuraFlash™

Zefr™ Memory / Data Center SSDs / CXL™ Memory

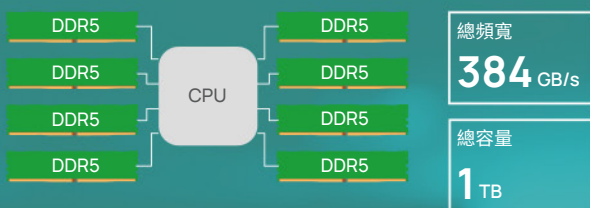


CXL™ 記憶體模組

打造記憶體池 實現高密度運算需求

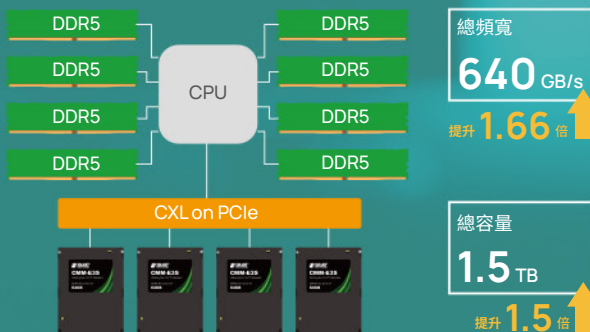
僅使用 DDR5 記憶體

SMART DDR5 頻寬：48GB/s
SMART DDR5 容量：128GB



同時使用 DDR5 和 CMM-E3S 記憶體模組

SMART DDR5 頻寬：48GB/s
SMART DDR5 容量：128GB



CXL 2.0 記憶體擴充解決方案
CMM-E3S 128GB

CXL 2.0 相容 PCIe-Gen5 速度 (32GT/s)

提供 64GB DDR5 記憶體容量，
未來擴充最高可達 256GB

支援 CXL 2.0 外加的可靠性，
可用性和可維護性 (RAS) 功能

改善低延遲連接和記憶體一致性，
增強運算性能和效率

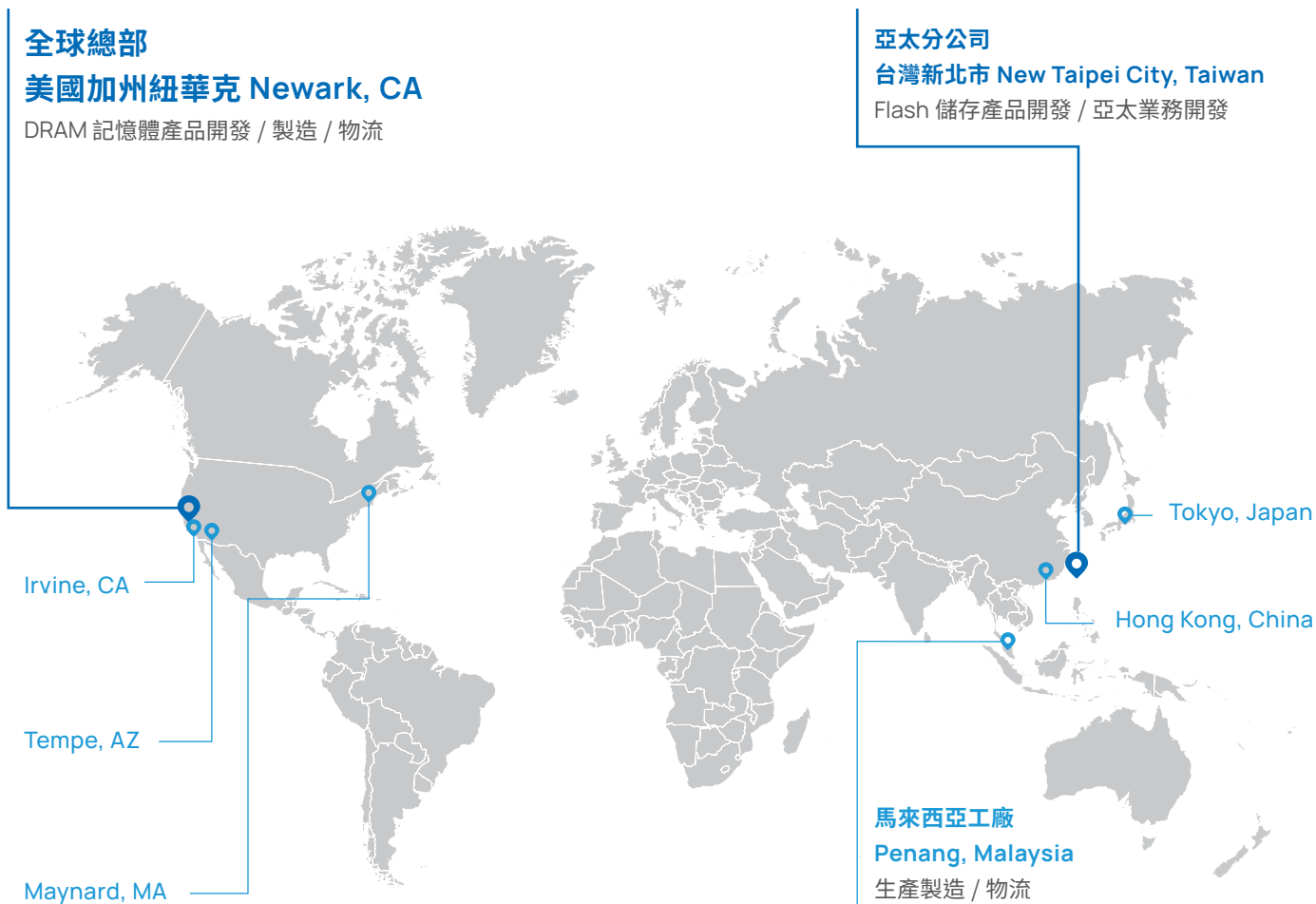
提供伺服器 DIMM 插槽額外的擴充能力和頻寬

關於 SMART Modular (世邁科技)

全球專業記憶體與儲存解決方案的領導者 SMART Modular (世邁科技)於美國加州成立超過三十年，為 SGH (Nasdaq: SGH) 控股集團旗下三大事業體之一，致力於開發中高階工業及企業級嵌入式記憶體產品，包含 DRAM 記憶體模組、SSD 固態硬碟、混合式解決方案等。除了標準化與強固型規格外，更針對不同產業應用提供客製化服務，跨足電腦、網通、電信、儲存設備、行動裝置、軍事、航空及工業應用等。SMART Modular (世邁科技)提供高度定製的產品設計能力、嚴謹可靠的測試服務與即時專業的技術支援，並與全球領導 OEM 客戶緊密合作，從產品設計到上市，均能提供高效可靠的解決方案，滿足各類工控產業的需求。

為什麼選擇 SMART Modular (世邁科技)?

- 提供超過30年專業經驗：致力於為全球頂尖 OEM 提供專業記憶體、快閃記憶體儲存和混合解決方案
- 提供品質保證的先進產品：從設計階段開始，通過製造與供應鏈的配合實現創新想法
- 與客戶保持長久密切的合作關係：提供客製化設計能力、技術支援和測試服務
- 與供應商建立長期合作夥伴關係：善用主要供應商的定價優勢、供貨能力和產品壽命
- 配合產品生命週期接單生產：客戶產品生命週期內提供長期穩定的支援
- 廣泛的客戶群：服務各種行業領域，包括資料中心、儲存伺服器、HPC、邊緣運算、IIoT、網路和工業市場等客戶



DuraMemory™

專為高度密集工作量而生 耐用可靠工業級記憶體

SMART Modular (世邁科技) DuraMemory 工業級記憶體系列產品提供卓越的品質、耐用性及可靠性，可滿足現今嚴苛多樣化的工業規格及企業級應用需求。所有 DuraMemory 產品皆有 SMART Modular (世邁科技) 在設計、製造、測試和物流各方面的專業團隊全力支援，提供更多一層的信心和安全性，讓產品達到最高標準的耐用性和可靠性，同時滿足工業工作負載需求，達到超乎預期的性能表現。

高可靠性企業級品質

三重壓力測試和
Burn-In 燒機試驗

加密及其他功能



DuraMemory 產品系列

DDR5 / DDR4 / DDR3



NVDIMM



LRDIMM



RDIMM



UDIMM



SODIMM



Mini DIMM

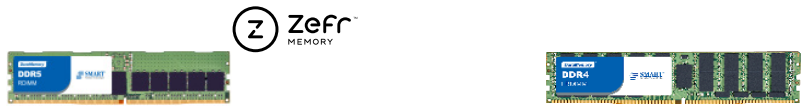


XRDIMM



MIP™

伺服器/資料中心



| DIMM Type | RDIMM | | LRDIMM |
|------------------------|-----------|--------------|------------|
| Technology | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
| Density | 16GB-64GB | 4GB-256GB | 64GB-256GB |
| Height | 31.25mm | 31.25/24.4mm | 31.25mm |
| Configuration | 80bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 4800 | 2666-3200 | 2666 |
| Voltage | 1.1V | 1.2V | 1.2V |
| Operating Temperature* | C Temp | C/I Temp | C Temp |

刀鋒/小型伺服器



| DIMM Type | VLP RDIMM | | VLP/ULP Mini RDIMM | |
|------------------------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| Technology | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
| Density | 32GB | 4GB-64GB | 8GB-32GB | 2GB-8GB |
| Height | 18.75mm | 18.75mm | 18.75/17.78mm | 18.75/18.3/17.78mm |
| Configuration | 80bit | 72bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 4800 | 2666-3200 | 2666-3200 | 1333-1600 |
| Voltage | 1.1V | 1.2V | 1.2V | 1.35V/1.5V |
| Operating Temperature* | C Temp | C/I Temp | C Temp | C/I Temp |

網通



| DIMM Type | UDIMM | | UDIMM ECC | |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Technology | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
| Density | 8GB-32GB | 4GB-32GB | 16GB | 4GB-32GB |
| Height | 31.25mm | 31.25mm | 31.25mm | 31.25mm |
| Configuration | 64bit | 64bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 4800 | 2666-3200 | 4800 | 2666-3200 |
| Voltage | 1.1V | 1.2V | 1.1V | 1.2V |
| Operating Temperature* | C Temp | C/I Temp | C Temp | C/I Temp |

*C Temp (0°C to +70°C); I Temp (-40°C to +85°C)

電信



| DIMM Type | SODIMM | | SODIMM ECC | | SODIMM ECC |
|------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Technology | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
| Density | 8GB-32GB | 2GB-32GB | 4GB-32GB | 2GB-16GB | 2GB-8GB |
| Height | 30mm | 30mm | 30mm | 30/25.4mm | 30mm |
| Configuration | 64bit | 64bit | 72bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 4800 | 2400-3200 | 2666-3200 | 1600-1866 | 1600 |
| Voltage | 1.1V | 1.2V | 1.2V | 1.35V/1.5V | 1.35V/1.5V |
| Operating Temperature* | C Temp | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp |

小型系統



| DIMM Type | VLP UDIMM | VLP/ULP UDIMM ECC | |
|------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Technology | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
| Density | 4GB-8GB | 16GB-32GB | 4GB-8GB |
| Height | 18.3mm | 17.78mm | 18.75/18.3mm |
| Configuration | 64bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 1600 | 2666-3200 | 1600 |
| Voltage | 1.35V/1.5V | 1.2V | 1.35V/1.5V |
| Operating Temperature* | C Temp | C/I Temp | C Temp |

航空/軍事



| DIMM Type | XRDIMM ECC | SODIMM ECC | |
|------------------------|------------|------------|------------|
| Technology | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
| Density | 4GB-8GB | 4GB-32GB | 2GB-16GB |
| Height | 38mm | 30mm | 30/25.4mm |
| Configuration | 72bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 1600 | 2666-3200 | 1600-1866 |
| Voltage | 1.35V/1.5V | 1.2V | 1.35V/1.5V |
| Operating Temperature* | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp |

*C Temp (0°C to +70°C); I Temp (-40°C to +85°C)

工業寬溫 I-Temp (-40 °C to +85 °C)

I Temp Server DIMM



| DIMM Type | RDIMM | | VLP RDIMM | | VLP/ULP Mini RDIMM |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|--------------------|
| Technology | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
| Density | 4GB-256GB | 2GB-32GB | 4GB-64GB | 4GB-16GB | 2GB-8GB |
| Height | 31.25/24.4mm | 30mm | 18.75mm | 18.75mm | 18.75/18.3/17.78mm |
| Configuration | 72bit | 72bit | 72bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 2666-3200 | 1333-1866 | 2666-3200 | 1600-1866 | 1333-1600 |
| Voltage | 1.2V | 1.35V/1.5V | 1.2V | 1.35V/1.5V | 1.35V/1.5V |
| Operating Temperature | I Temp | I Temp | I Temp | I Temp | I Temp |

I Temp UDIMM



| DIMM Type | UDIMM | | UDIMM ECC |
|-----------------------|-----------|------------|-----------|
| Technology | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
| Density | 4GB-32GB | 2GB-8GB | 4GB-32GB |
| Height | 31.25mm | 30mm | 31.25mm |
| Configuration | 64bit | 64bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 2666-3200 | 1600-1866 | 2666-3200 |
| Voltage | 1.2V | 1.35V/1.5V | 1.2V |
| Operating Temperature | I Temp | I Temp | I Temp |

I Temp SODIMM



| DIMM Type | SODIMM | | SODIMM ECC | SODIMM ECC |
|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Technology | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
| Density | 2GB-32GB | 128MB-16GB | 4GB-32GB | 2GB-16GB |
| Height | 30mm | 30mm | 30mm | 30/25.4mm |
| Configuration | 64bit | 64bit | 72bit | 72bit |
| Speed (MT/s) | 2400-3200 | 1600-1866 | 2666-3200 | 1600-1866 |
| Voltage | 1.2V | 1.35V/1.5V | 1.2V | 1.35V/1.5V |
| Operating Temperature | I Temp | I Temp | I Temp | I Temp |

I Temp VLP/ULP UDIMM



| DIMM Type | ULP UDIMM ECC | VLP/ULP Mini UDIMM ECC |
|-----------------------|---------------|------------------------|
| Technology | DDR4 | DDR4 |
| Density | 16GB-32GB | 4GB-32GB |
| Height | 17.78mm | 18.75/17.78mm |
| Configuration | 72bit | 72/64bit |
| Speed (MT/s) | 2666-3200 | 2400-3200 |
| Voltage | 1.2V | 1.2V |
| Operating Temperature | I Temp | I Temp |



Zefr (Zero Failure Rate) 記憶體模組測試流程 可淘汰90%以上可靠性不足的記憶體模組

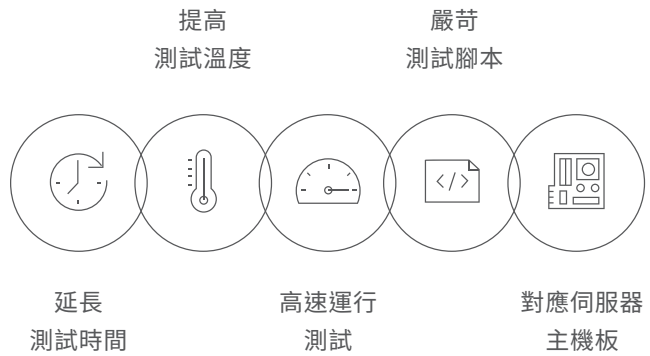
Zefr 提供專業嚴謹的出廠前記憶體測試篩選流程，特別針對 OEM 出廠及 SMART Modular (世邁科技)生產的記憶體模組，可優化記憶體子系統以維持最長運行時間。

業界標準記憶體可靠性不足以支援 嚴苛應用需求



Zefr 以實際操作條件篩選記憶體

結合五種關鍵測試，嚴格篩選並過濾掉有不良疑慮的記憶體模組。



更多相關資訊，請至官網查詢 www.smtreports.com/zefr/

Zefr 模組優勢

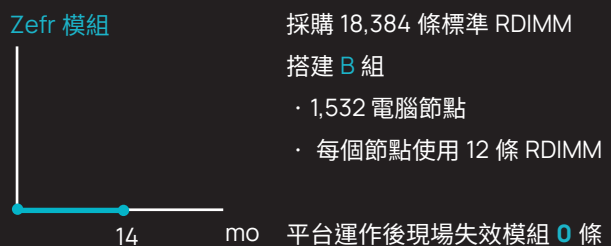
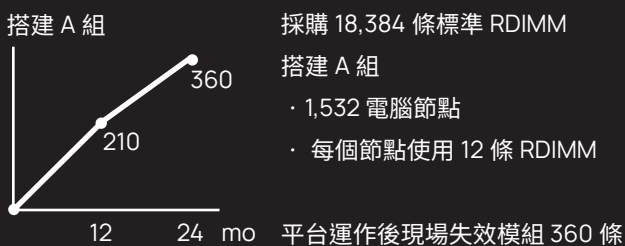
提升投資報酬率

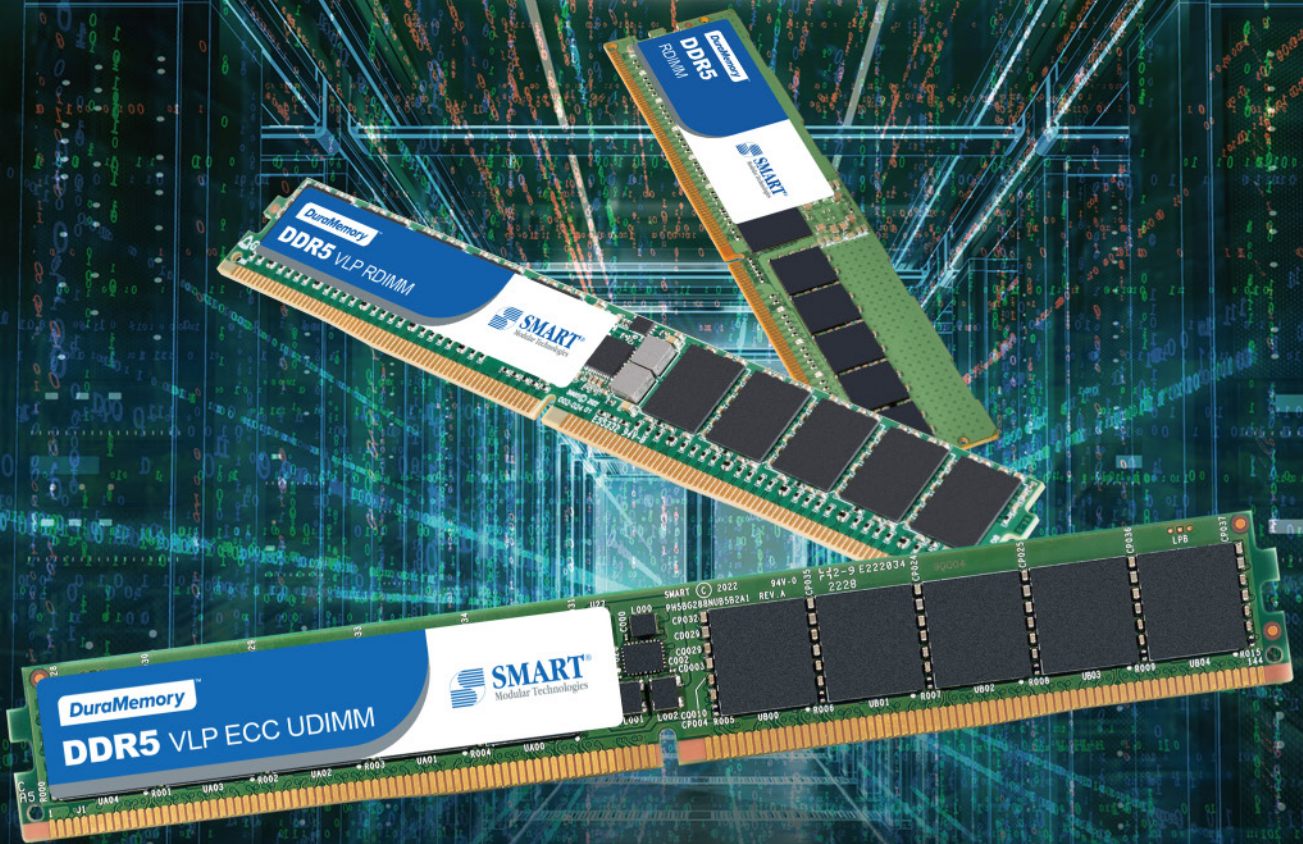
最大化系統良率

加速洞察時間

案例分析

一家高性能運算(HPC)系統整合商構建兩套相同的系統，一套系統使用標準模組，另一套使用 Zefr 模組。





DDR5 記憶體模組

專為次世代高效能運算系統而設計

主板配置 12V 電源管理 IC
提供更佳訊號完整性並降低雜訊

每通道輸出 40-bit 的雙通道架構
提供更高傳輸效率及更低延遲

在讀取資料框架內
產生 CRC 循環冗餘校驗

每個通道的獨立時脈
可改善訊號完整性
降低雜訊容限

On-die ECC 可針對
DDR5 記憶體陣列內的位元錯誤
進行糾錯更正

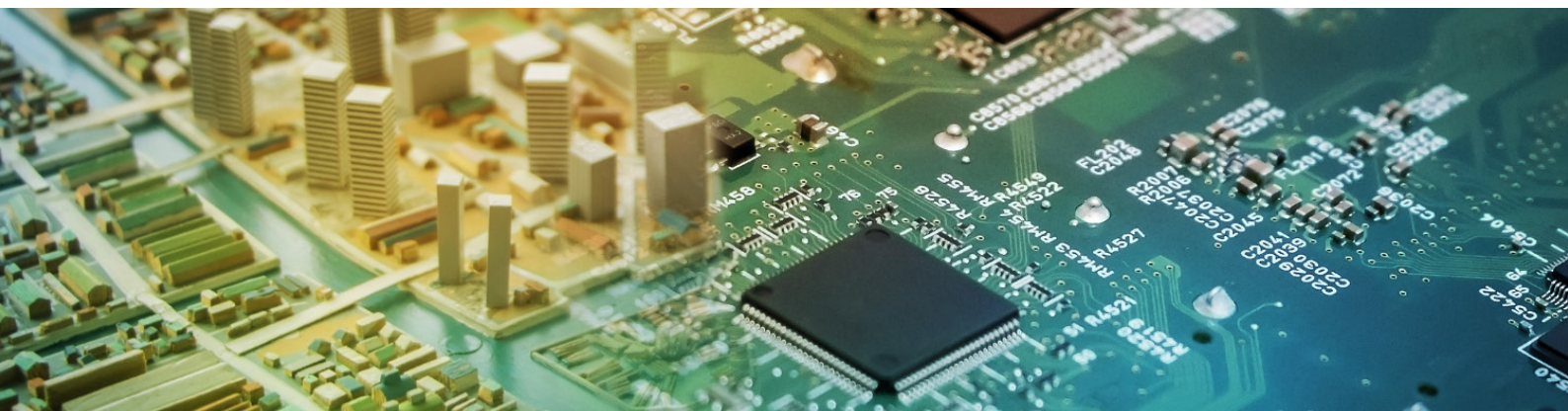
DuraFlash™

絕佳可靠的工業級快閃儲存解決方案

SMART Modular (世邁科技)提供多種尺寸規格的工業級快閃儲存產品，包含工業用 SSD、工業用 BGA、工業用記憶卡及工業用隨身碟，以滿足與日劇增的嵌入式儲存需求，特別適用在電信、網通、儲存、工業控制、工業物聯網、交通運輸、醫療和影像監控等垂直市場應用。SMART Modular (世邁科技)非常重視設計，採購和製造週期各方面的品質控管和流程，從選擇符合嚴苛要求的專業材料和元件供應商開始，產品組裝完成後，還需經過嚴謹的設計驗證測試 (DVT)，要求每件成品通過各項標準，完成最終審查後才能正式出貨。

附加價值特點：

- 專為企業和工業應用設計
- 提供商規溫度 (0°C ~ +70°C) 和工規寬溫 (-40°C ~ +85°C)
- 提供各式 NAND 技術：TLC, eTLC, MLC, SLC, 和 pSLC
- 大規模 Burn-in 燒機以確保現場運作的可靠性
- 提供客製化進階功能
- SafeDATA™ 斷電資料保護技術可在意外斷電事故時確保存取中資料的安全
- 多種容量可供選擇



DuraFlash 產品系列



DuraFlash SSDs

- 2.5"
- M.2 (2242/2280/22110)
- mSATA
- Slim SATA



DuraFlash BGA

- eMMC



DuraFlash Cards

- SD Cards
- microSD Cards
- CF Cards



DuraFlash USB

- eUSB
- USB Flash Drives

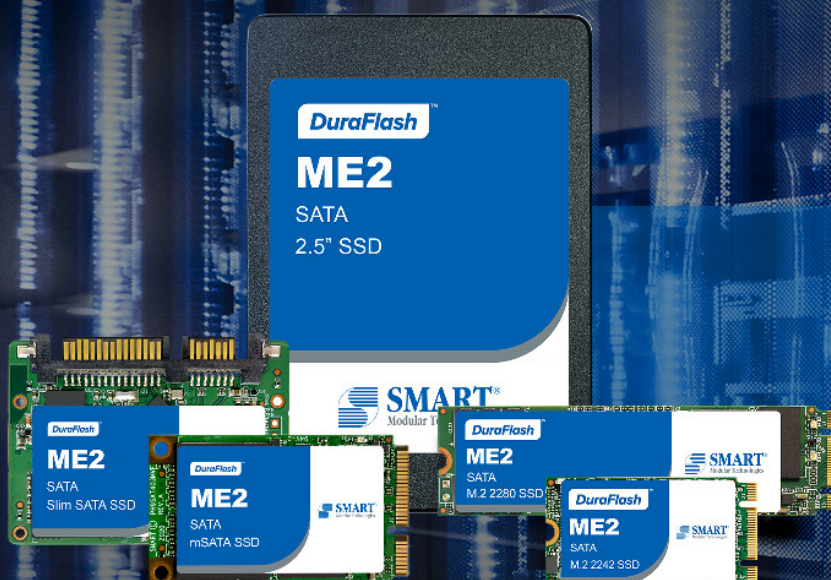


Enterprise/ Data Center SSDs

- EDSFF

資料中心專用開機碟

- 採用最新一代 3D NAND 技術
- 提供 5 年使用期間每日可以整盤寫入 (DWPD) 1 次的耐用度
- 選配 SafeDATA™ 斷電資料保護技術
- 搭載獨家專利 NVMSentry™ 韌體架構
- 符合 TCG Opal 2.0 規範及 AES 256 加密技術
- 支援工業寬溫 I-Temp (-40°C ~ +85°C)



ME2 固態硬碟 SATA SSDs



MP3000 固態硬碟 PCIe NVMe SSDs

ME2 工業級固態硬碟



Specifications

| Interface | | SATA III 6Gb/s | | | | |
|------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Form Factor | | 2.5" | M.2 2242-D3-B-M | M.2 2280-D3-B-M | mSATA (MO-300A) | Slim SATA (MO-297) |
| Max. Performance | Read | 540MB/s | 540MB/s | 540MB/s | 540MB/s | 540MB/s |
| | Write | 450MB/s | 450MB/s | 450MB/s | 450MB/s | 450MB/s |
| Capacity | | 240GB-1920GB | 240GB-960GB | 240GB-1920GB | 240GB-1920GB | 240GB-1920GB |
| DRAM | | V | V | V | V | V |
| Input Voltage | | 5V ± 10% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% |
| Data Integrity | SafeDATA | Optional | - | Optional | - | - |
| | Advanced Error Detection & Correction | V | V | V | V | V |
| | AES 256 Encryption | V | V | V | V | V |
| Security | TCG OPAL 2.0 | V | V | V | V | V |
| | Security Erase (ATA) | V | V | V | V | V |
| Reliability | MTBF | > 2,000,000 hours | | | | |
| | Shock Operating | 1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction | | | | |
| | Vibration Operating | 20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis | | | | |
| Operating Temperature* | | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp |
| Durability | DWPD (for 5 Years) | 1 (Enterprise Workload) | 1 (Enterprise Workload) | 1 (Enterprise Workload) | 1 (Enterprise Workload) | 1 (Enterprise Workload) |
| | Pseudo-SLC | - | - | - | - | - |
| | Thermal Throttling | V | V | V | V | V |
| | Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM | V | V | V | V | V |

應用領域

- AI
- 工業
- 監控
- 資料中心
- 網通

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

MP3000 工業級固態硬碟



Specifications

| | | | | |
|------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|
| Interface | | PCIe Gen4 x4 | | |
| Form Factor | | EDSFF E1.S | M.2 2280-D3-M | M.2 22110-D3-M |
| Max. Performance | Read | 3500MB/s | 3500MB/s | 3500MB/s |
| | Write | 2000MB/s | 2000MB/s | 2000MB/s |
| Capacity | | 240GB-1920GB | 240GB-1920GB | 240GB-1920GB |
| DRAM | | V | V | V |
| Input Voltage | | 12V ± 10% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% |
| SafeDATA | | Optional | Optional | Optional |
| Data Integrity | Advanced Error Detection & Correction | V | V | V |
| | AES 256 Encryption | V | V | V |
| Security | TCG OPAL 2.0 | V | V | V |
| | Security Erase (ATA) | V | V | V |
| Reliability | MTBF | > 2,000,000 hours | | |
| | Shock Operating | 1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction | | |
| | Vibration Operating | 20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis | | |
| Operating Temperature* | | C/I Temp | C/I Temp | C/I Temp |
| Durability | DWPD (for 5 Years) | 1 (Enterprise Workload) | 1 (Enterprise Workload) | 1 (Enterprise Workload) |
| | Pseudo-SLC | Optional | - | - |
| | Thermal Throttling | V | V | V |
| | Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM | V | V | V |

應用領域

- AI
- 資料中心
- HPC 高性能運算
- 網通
- 儲存伺服器
- 電信

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

CS310 工業級固態硬碟



Specifications

| Interface | | SATA III 6Gb/s | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Form Factor | | 2.5" | M.2 2242-D2-B-M | M.2 2280-D2-B-M | mSATA (MO-300A) |
| Max. Performance | Read | 560MB/s | 560MB/s | 560MB/s | 560MB/s |
| | Write | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s |
| Capacity | | 128GB-1TB | 128GB-1TB | 128GB-1TB | 128GB-1TB |
| DRAM | | - | - | - | - |
| Input Voltage | | 5V ± 10% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% |
| Data Integrity | SafeDATA | - | - | - | - |
| | Advanced Error Detection & Correction | V | V | V | V |
| Security | AES 256 Encryption | - | - | - | - |
| | TCG OPAL 2.0 | - | - | - | - |
| | Security Erase (ATA) | V | V | V | V |
| Reliability | MTBF | > 3,000,000 hours | | | |
| | Shock Operating | 1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction | | | |
| | Vibration Operating | 20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis | | | |
| | Operating Temperature* | I Temp | I Temp | I Temp | I Temp |
| Humidity | | 40°C, Operation: 90% RH, Storage: 93% RH | | | |
| Durability | Pseudo-SLC | - | - | - | - |
| | Thermal Throttling | V | V | V | V |
| | Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM | V | V | V | V |
| | | | | | |

應用領域

- 網路路由器和交換器
- 工廠自動化控制
- 邊緣運算
- 交通運輸

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

CS410 工業級固態硬碟



Specifications

| Interface | | SATA III 6Gb/s | | | |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Form Factor | | 2.5" | M.2 2280-D2-B-M | M.2 2242-D2-B-M | mSATA (MO-300A) |
| Max. Performance | Read | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
| | Write | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 500MB/s |
| Capacity | | 128GB-1TB | 128GB-512GB | 128GB-1TB | 128GB-1TB |
| DRAM | | V | V | V | V |
| Input Voltage | | 5V ± 10% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% | 3.3V ± 5% |
| Data Integrity | SafeDATA | - | - | - | - |
| | Advanced Error Detection & Correction | V | V | V | V |
| Security | AES 256 Encryption | - | - | - | - |
| | TCG OPAL 2.0 | - | - | - | - |
| | Security Erase (ATA) | V | V | V | V |
| Reliability | MTBF | > 1,000,000 hours | | | |
| | Shock Operating | 1500 g half-sine, 0.5 msec, 1 shock along each axis, X, Y, Z in each direction | | | |
| | Vibration Operating | 20G 80-2000Hz, 1.52mm 20-80Hz, 3 axis | | | |
| | Operating Temperature* | C Temp | C Temp | C Temp | C Temp |
| Humidity | | 40°C, Operation: 90% RH, Storage: 93% RH | | | |
| Durability | Pseudo-SLC | - | - | - | - |
| | Thermal Throttling | V | V | V | V |
| | Wear-Leveling / Garbage Collection / TRIM | V | V | V | V |
| | | | | | |

應用領域

- POS / Kiosk 零售應用
- 網路路由器和交換器
- 邊緣運算
- 工廠自動化控制
- 用於博弈機和工業控制的單板電腦

*C Temp (0 °C to +70 °C) ; E Temp (-25 °C to +85 °C) ; I Temp (-40 °C to +85 °C)

SD 工業級記憶卡



| Specifications | XL+ | RD230 |
|------------------------|----------|------------|
| Interface | SD 3.01 | SD 6.1 |
| Form Factor | SD Card | |
| NAND Type | SLC | TLC |
| Max. Performance | Read | 49MB/s |
| | Write | 38MB/s |
| Capacity | 4GB-32GB | 32GB-256GB |
| Operating Temperature* | C/I Temp | I Temp |

應用領域

- 智慧車載系統、導航和車用娛樂系統
- 商用數位攝影機
- 電信和通訊
- 嵌入式運算
- 醫療設備

MicroSD 工業級記憶卡



| Specifications | RD130m | RD230m | RD530m |
|------------------------|--------------|------------|------------|
| Interface | SD 3.01 | SD 6.1 | SD 6.1 |
| Form Factor | microSD Card | | |
| NAND Type | SLC | TLC | TLC |
| Max. Performance | Read | 68MB/s | 95MB/s |
| | Write | 50MB/s | 55MB/s |
| Capacity | 1GB-4GB | 32GB-256GB | 64GB-256GB |
| Operating Temperature* | E/I temp | I Temp | C Temp |

應用領域

- 智慧車載系統、導航和車用娛樂系統
- 電信和通訊
- 嵌入式運算
- 用於博弈機的單板電腦
- 商用數位攝影機
- 工業儀錶和工業控制
- 醫療設備

*C Temp (0°C to +70°C) ; E Temp (-25°C to +85°C) ; I Temp (-40°C to +85°C)

CF 工業級記憶卡



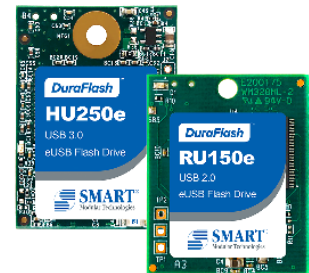
| Specifications | H9 | XL |
|------------------------|--------------|-----------|
| Interface | CF 6.1 | CF 4.1 |
| Form Factor | CompactFlash | |
| NAND Type | SLC | |
| Max. Performance | Read | 100MB/s |
| | Write | 70MB/s |
| Capacity | 64MB-64GB | 128MB-8GB |
| Operating Temperature* | C/I Temp | C/I Temp |

應用領域

- 用於博弈機的單板電腦
- 通訊
- 國防
- 工業控制設備
- 網通
- 印表機

工業級 USB

| Specifications | RU150e | HU250e |
|------------------------|---|--|
| Interface | USB 2.0 | USB 3.0 |
| NAND Type | SLC | |
| Max. Performance | Read | 35MB/s |
| | Write | 27MB/s |
| Capacity | 1GB-32GB | 8GB-32GB |
| Operating Temperature* | C/I Temp | I Temp |
| Connector | Pin pitch 2.54mm, H: 7.50mm Pin pitch 2.54mm, H: 9.78mm Pin pitch 2.00mm, H: 3.68mm | Pin pitch 2.00mm, H: 3.68mm Pin pitch 2.54mm, H: 7.42mm |



應用領域

- 用於國防、博弈機和工業控制應用的單板電腦
- ATCA 運算刀鋒伺服器
- 業界標準伺服器

*C Temp (0°C to +70°C) ; E Temp (-25°C to +85°C) ; I Temp (-40°C to +85°C)

次世代資料中心 SSDs

滿足三大資料中心應用需求

SMART Modular (世邁科技) 次世代資料中心固態硬碟專為滿足有嚴苛需求的應用及嚴格的 SLA 而設計。當今的高密度運算非常看重資料中心伺服器的表現，也持續要求基礎硬體提供一致且可靠的性能，若要滿足以資料存取狀況為主的服務等級協定 (Service-level agreement: SLA)，SSD 儲存控制器將扮演關鍵的角色。

專為低功耗而設計

SMART Modular (世邁科技) 資料中心 SSD 系列採用硬體加速架構，在低溫運轉下依然保持最佳性能。低功耗運轉有助於達到節能標準，並可增加伺服器密度。在標準 2U/24 配置中，每台伺服器最多可節省 200W 的功率。



最高性能



低功耗



企業級功能

SMART 資料中心固態硬碟提供高速運行，實現最大資料吞吐量

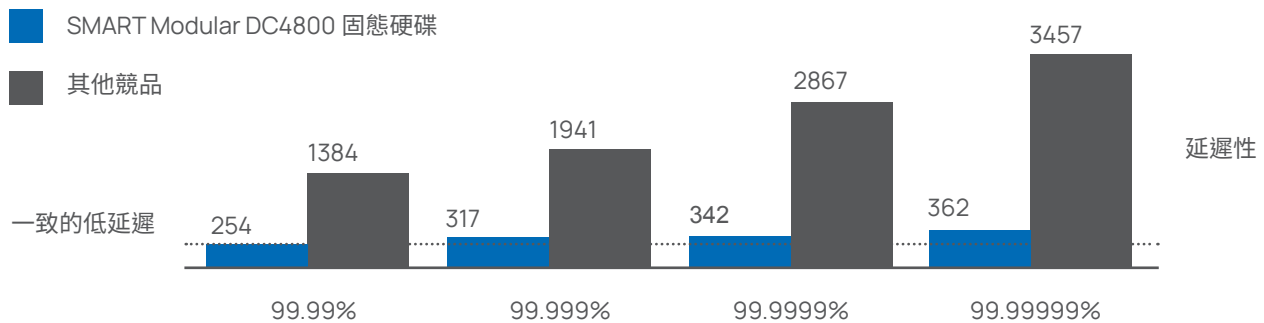
低功耗架構讓固態硬碟維持低溫運轉

專為各種資料中心應用而設計

| | 讀取 | 寫入 |
|---------------------|----------|----------|
| 連續 (GB/s) Gen4 | 7.1 GB/s | 4.6 GB/s |
| 隨機 (KIOP/s) Gen4 | 1,490 | 180 |

- 領先業界的低閒置有效功率
 - 減少熱能讓 NAND 加快運轉速度
 - 降低加裝 SSD 散熱裝置所需營運支出
- 成本

- E2E 數據保護、TCG OPAL、eDrive
- 安全平台啟動
- 多個命名空間
- 每日整盤寫入 (DWPD) 1次和3次
- 遠程記錄 S.M.A.R.T. 檢測系統/每日運作狀況
- 外部斷電保護



通過 99.99999% QoS 達到超低且一致的延遲性



| | Read(GB/s) |
|------|------------|
| 競品 M | 4,026 |
| 競品 T | 3,194 |
| 競品 W | 3,300 |

| | Write(GB/s) |
|------|-------------|
| 競品 M | 2,180 |
| 競品 T | 1,253 |
| 競品 W | 3,196 |

DC4800 PCIe NVMe 資料中心固態硬碟 傳輸快 散熱佳 性能穩定

適用於大型資料中心和雲端伺服器應用

保持伺服器 PCIe Gen3/4/5 傳輸通道
最大持續性能

極佳數據傳送服務 (QoS) ，
在 99.99999% 的工作負載中
保持一致的低延遲

通過硬體加速達到低功耗運轉，
顯著改善散熱調節，
提升 15-20% 的讀寫次數和資料吞吐量

DC4800 產品系列

| Form Factor | Capacity |
|-------------|------------------------|
| U.2 | 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB |
| EDSFF E1.S | 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB |



U.2



EDSFF E1.S



Think Memory. Think SMART.

如需了解更多產品資訊，請與SMART Modular (世邁科技)
業務團隊連絡或至官網查詢。

*產品圖僅供行銷宣傳使用，實際產品貼紙可能與圖片有所出入。

亞太分公司

☎: (+886) 2-7705-2700

☎: (+886) 2-7705-2701

✉: sales.asia@smartm.com



SMART Modular官方網站



SMART LinkedIn

